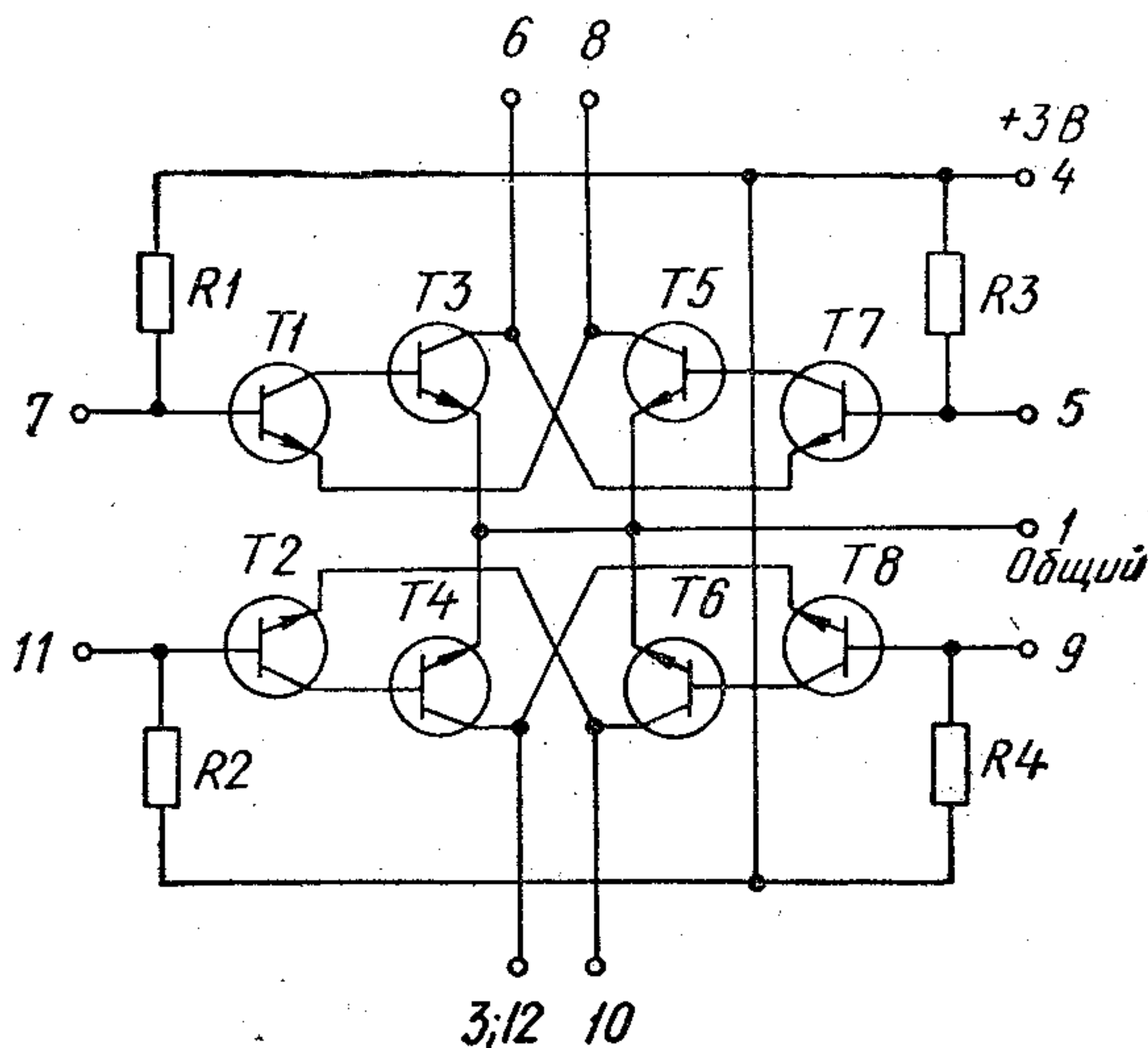


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$)

Напряжение источника питания	+3 В $\pm 10\%$
Потребляемая мощность	не более 19 мВт
Ток потребления	не более 4,8 мА
Верхний уровень выходного напряжения Δ при $U_{\text{вх}} = 0,5 \text{ В}$	не менее 2,3 В
Нижний уровень выходного напряжения Δ при $U_{\text{вх}} = 0,5 \text{ В}$	не более 0,25 В
Помехоустойчивость	не менее 0,25 В
Нагрузочная способность	6

Δ Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

верхний уровень выходного напряжения при $U_{вх} = 0,48$ В	не менее 2,1 В
нижний уровень выходного напряжения при $U_{вх} = 0,48$ В	не более 0,3 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ○

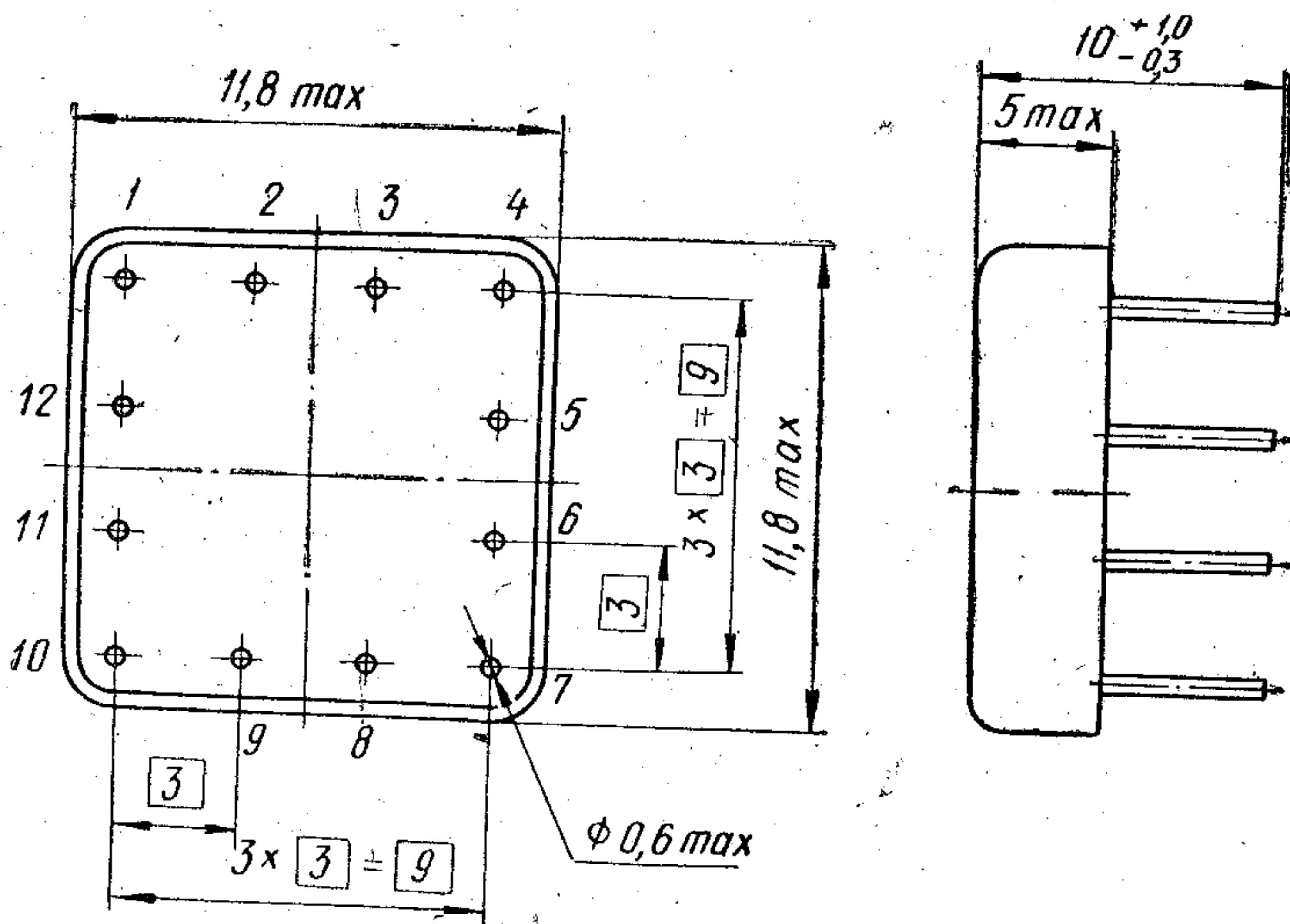
Максимальный ток нагрузки	7,2 мА
Максимальная частота переключения	15 МГц
Ток нагрузки *	не более 7,6 мА
Напряжение источника питания *	не более 4,2 В
Входное напряжение *	от минус 0,45 до +4,7 В

○ При температуре окружающей среды, допускаемой условиями эксплуатации.
* Время воздействия — не более 1 с.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 243 (К243)
Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольном металлополимерном корпусе.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса — не более 1,5 г

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 243 (К243)

Общие данные

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

Место расположения первого вывода указывается на крышке корпуса маркировочным знаком.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация для микросхем серии:

243

диапазон частот от 5 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

К243 (кроме К243АГ1)

диапазон частот от 5 до 600 Гц
ускорение до 5 g

для микросхемы К243АГ1

диапазон частот от 1 до 600 Гц
ускорение до 10 g

Многократные удары для микросхем серии:

243

ускорение до 150 g
длительность удара от 1 до 3 мс

К243 (кроме К243АГ1)

ускорение до 15 g
длительность удара от 2 до 15 мс

для микросхемы К243АГ1

ускорение до 75 g
длительность удара от 2 до 6 мс

Одиночные удары для микросхем серии 243:

ускорение до 1000 g
длительность удара от 0,2 до 1,0 мс

Линейные нагрузки для микросхем серии:

243

ускорение до 150 g

К243

ускорение до 25 g

Температура окружающей среды для микросхем серии:

243 от минус 60 до +70° С

К243 (кроме К243АГ1) от +1 до +50° С

для микросхемы К243АГ1 от минус 10 до +55° С

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 243 (K243)

Общие данные

Многократные циклические изменения температуры для микросхем серии:

243	от минус 60 до +70° С
K243 (кроме K243AГ1)	от +1 до +50° С
для микросхемы K243AГ1	от минус 10 до +55° С

Относительная влажность воздуха для микросхем серии 243 при температуре +40° С, серии K243 (кроме K243AГ1) при температуре +20° С и для микросхемы K243AГ1 при температуре +25° С

98%

Для микросхем серии 243:

Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка \bigcirc 10 000 ч

Срок сохраняемости \bigcirc для микросхем серии:

243	12 лет
K243	6 лет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с требованиями, изложенными ниже.

Микросхемы серии 243 следует устанавливать на печатную плату с зазором $1^{+0,1}$ мм, серии K243 — с зазором $1^{+,5}$ мм. Крепление осуществляется методом припайки к выводам без какого-либо механического крепления.

Лужение выводов микросхем следует производить методом двукратного погружения в расплавленный припой с температурой не более 250° С в течение 2 с, интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин.

Пайку выводов микросхем допускается производить одножальным паяльником с температурой не более 280° С в течение 3 с, интервал между пайками двух соседних выводов — не менее 10 с, или групповым паяльником с температурой расплавленного припоя не более 265° С в течение 3 с, интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы — не менее 5 мин. Жало паяльника должно быть заземлено. Расстояние от корпуса до места лужения или пайки — не менее 1 мм.

\bigcirc В условиях и режимах, допускаемых ОТУ, ЧТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 243 (К243)

Общие данные

Рекомендуется применять припой, флюсы и жидкости для очистки от флюса по ОСТ 11 029.001—74.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лакокрасочным покрытием в 2 слоя, устойчивым к воздействию условий эксплуатации, рекомендуемое покрытие — лак УР-231 по МРТУ 6-10-863—69 и Э-4100 по МРТУ 6-10-857—69.

Не допускается пребывание микросхем в среде, содержащей водород.